

证券代码：002008

证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024006

| | |
|--------------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 高盛证券（10月24日） 天风证券（10月28日） 招商证券（11月1日） 美银美林策略会（11月5日） 招商证券策略会（11月5日） 花旗银行策略会（11月5日） 瑞银资管（11月7日） 华西证券策略会（11月7日） 国盛机械（11月8日） 摩根士丹利（11月11日） 大和证券策略会（11月12日） 鹏华基金（11月20日） 财通证券策略会（11月21日） 富国基金（11月26日） 富瑞金融（11月27日） 天风证券策略会（11月28日） 中泰证券（11月28日） |
| 时间 | 2024年10月24日-2024年11月29日 |
| 地点 | 北京万豪大酒店 上海金陵紫金山大酒店 |

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>深圳君悦大酒店</p> <p>成都首座万豪大酒店</p> <p>香港港岛香格里拉大酒店</p> <p>杭州万豪大酒店</p> <p>深圳福田香格里拉大酒店</p> <p>公司会议室</p> |
| <p>上市公司接待 人员姓名</p> | <p>管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚</p> <p>证券事务代表王琳</p> <p>证券事务代表胡志毅</p> |
| <p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p> | <p>一、公司 2024 年第三季度经营情况</p> <p>今年以来，随着下游行业需求的逐渐恢复，公司经营情况逐步改善。公司前三季度实现营业收入 1,012,895.38 万元，归属于母公司的净利润 142,609.01 万元，扣除非经常性损益后净利润 37,526.59 万元，分别较上年同期增长 7.90%、124.21%、4.86%。</p> <p>二、公司 PCB 业务情况</p> <p>今年以来截止 9 月 30 日，PCB 设备业务实现营业收入 23.44 亿元，同比增加 105.55%。2024 年以来，随着普通多层板市场的竞争加剧，PCB 生产企业对设备效率的要求和自动化需求持续提升。在此背景下，公司开发推出了第二代钻房自动化方案及高功率阻焊激光直接成像系统、自动上下料机械成型机、电测与自动外观检查一体机、自动分拣包装机等自动化、数字化、智能化的解决方案可大幅降低下游客户的人力成本支出，提升客户端设备稼动率及产品品质，已获得客户高度认可。面对 AI 算力产业链持续爆发带来的高速高多层板、任意层 HDI 板、类载板、大尺寸 FC-BGA 封装基板等高阶 PCB 加工需求增长，公司推出了钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机、新型激光应用设备等系列产品方案，满足客户对高阶 PCB 加工工艺的要求。未来公司高阶 PCB 加工设备的销售占比将进一步提升。</p> |

另一方面，今年以来，众多国内及台资企业在东南亚市场的项目陆续落地，公司与国内多家知名厂商的泰国工厂及泰国 KCE 等当地较大规模的企业达成全面合作，相关订单显著增长。公司已组建海外运营团队，与内资企业联合打造高水平自动化产线，减少对技术人员的依赖，确保相关企业海外 PCB 产能稳定供应，并通过创新型产品及解决方案的广泛推广，力争将公司的品牌价值和影响力复制到海外地区，抓住 PCB 产业转移带来的市场机会，推动海外业务的持续增长。

三、通用工业激光加工设备市场复苏情况

近年以来，通用工业激光加工设备市场尤其是高功率激光加工设备需求有所复苏。今年，公司推出了全球首台 150KW 超高功率切割机，持续扩大在高端领域的市场影响力，与浙江鼎力、东南网架、中国石油、爱玛科技等客户达成合作。另一方面，根据市场需求，公司同步调整市场策略，持续加大对中低端市场的覆盖和拓展，高功率激光切割设备整体市占率稳步提升。公司在长沙、天津、常州、张家港、济南等地设厂，实现就近生产交付和服务，提升盈利能力。公司在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上持续取得突破，并持续加深与行业头部客户的紧密合作关系。

四、公司当下市场竞争力与未来发展

公司下游包括消费电子、PCB、新能源、半导体等行业，与宏观经济的整体运行密切相关，目前全球经济仍处于周期性波动当中。公司将持续落实公司“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大对基础器件以及行业专用设备业务的研发和投入，深耕细分行业，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位，推动公司业务实现持续高质量增长。

五、公司海外布局发展情况

| | |
|----------|--|
| | <p>当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，海外设备需求呈明显上升趋势，公司紧跟客户步伐，已高效组建起海外研发销售团队，力争抓住供应链多元化带来的市场机会。</p> <p>六、公司回购进展情况</p> <p>截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 12,310,392 股，占公司目前总股本的 1.17%，最高成交价格为 21.36 元/股，最低成交价格为 15.41 元/股，成交总金额为 250,072,212.26 元（不含交易费用）。</p> <p>七、公司质押情况</p> <p>目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 78.97%。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2024 年 11 月 29 日 |